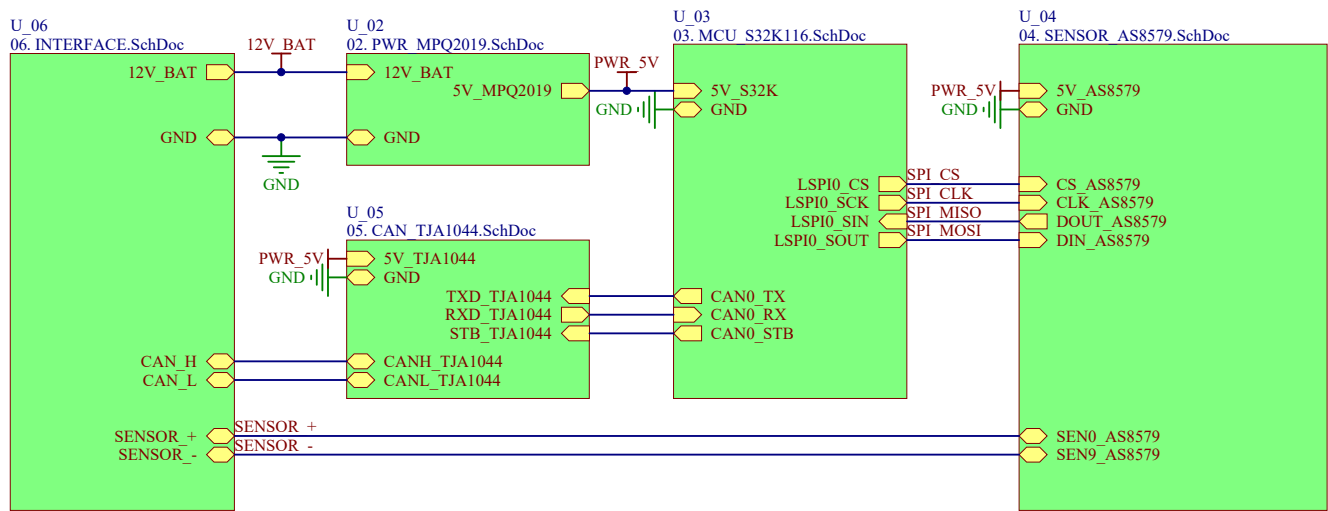
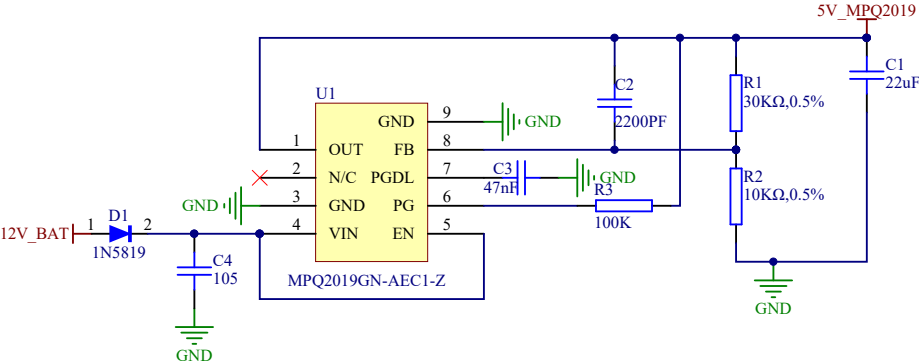
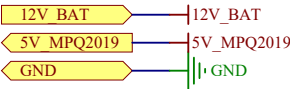


1. AS8579 Demo



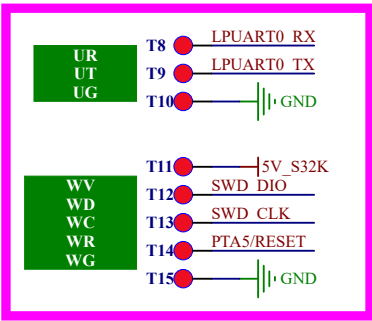
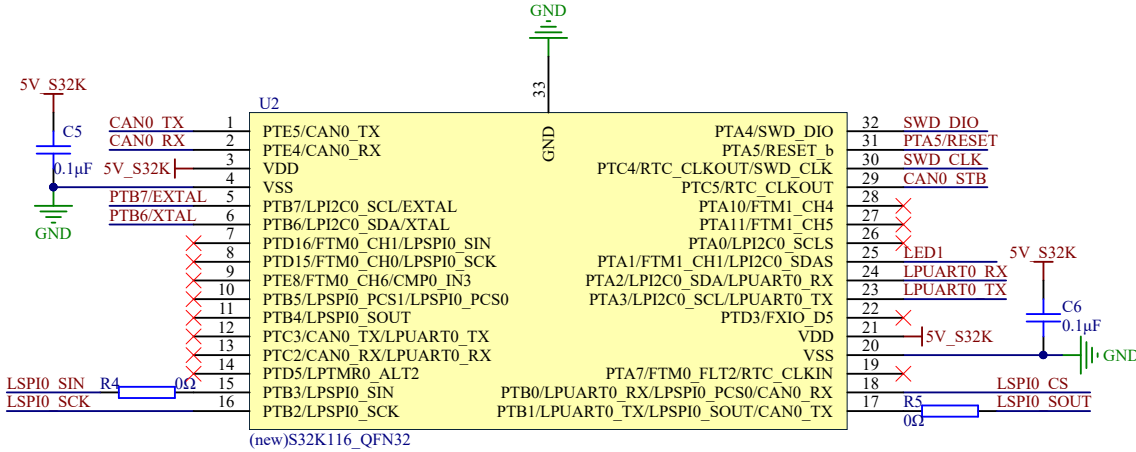
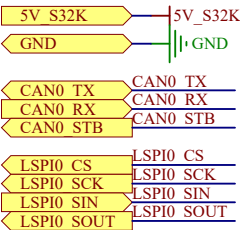
#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

2. PWR_MPQ2019



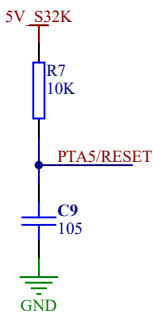
#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

3. MCU_S32K116

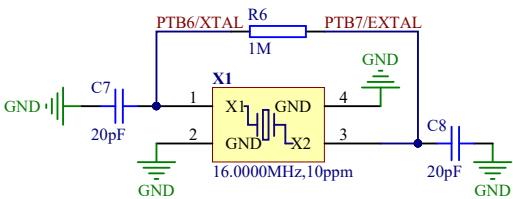


由于PCB尺寸限制，使用测试点跳线代替排针调试。

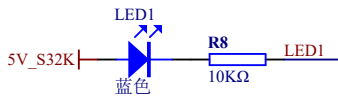
(1) 复位



(2) 外部晶振

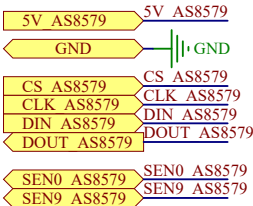


(3) LED指示灯



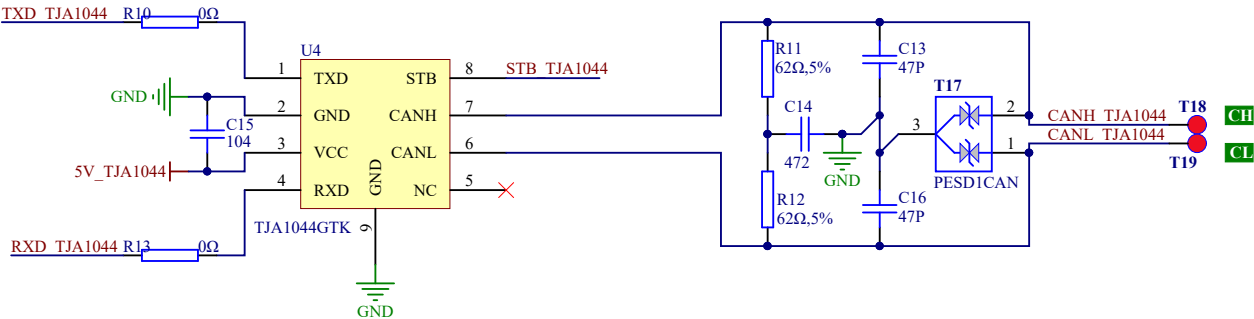
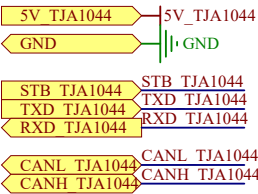
#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

4. SENSOR AS8579



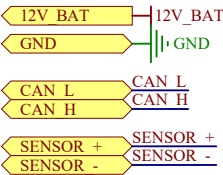
#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

5. CAN_TJA1044

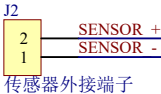
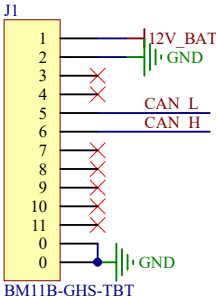


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

6. INTERFACE



▲主要接口
1、客户提供的接口（电源和CAN）
2、电容传感器连线接口
3、SWD下载程序接口
4、调试接口



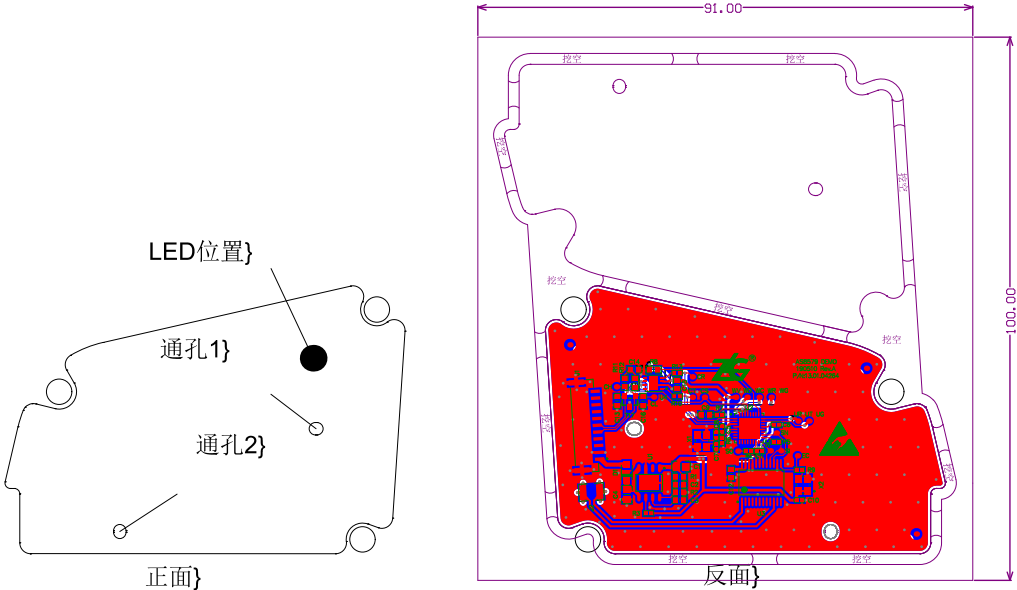
传感器外接端子

▲传感器外接端子，
使用英制1210封装

#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

PCB加工工艺要求

尺寸	91 mm x 100 mm		验收标准	IPC-600E IPC-6011/12		☒ IPC-II ☐ IPC-III																																				
板材	☒ FR4 TG140 ☐ FR4 TG170 ☐ 生益有胶材料 ☐ MEGTRON6 ☐ 其他:																																									
板层	☐ 单面 ☒ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10																																									
板厚	☐ 0.4mm ☐ 0.6mm ☐ 0.8mm ☐ 1.0mm ☐ 1.2mm ☐ 1.4mm ☒ 1.6mm ☐ 1.8mm ☐ 2.0mm																																									
铜厚	☐ 外层(完成铜厚) ☐ 1/2OZ ☒ 1OZ ☐ 2OZ																																									
丝印颜色	☒ 白色 ☐ 其他:																																									
阻焊颜色(亮光)	☒ 绿色 ☐ 黑色 ☐ 红色 ☐ 蓝色 ☐ 黄色 ☐ 其他:																																									
表面处理工艺	☒ 沉锡金 ☐ 无铅喷锡 ☐ 电镀锡金 ☐ 电镀软金 ☐ 化学沉锡 ☐ 光板 ☐ OSP																																									
特殊工艺	☒ 无 ☐ 按键镀硬金 ☐ 金手指 ☐ 半孔工艺 ☐ FPCB补强 ☐ 树脂塞孔 ☐ 电镀填孔																																									
是否阻焊塞孔	☒ 是, 但双面开窗除外 ☐ 否 ☐ 按文件																																									
交货方式	☒ 非拼板 ☐ 拼板 ☐ 分成单板交货																																									
Gerber输出: 英制、相对零点、抑制前导零、精度2:5				Ver 19.01.16																																						
NC Drill输出: 英制、相对零点、抑制前导零、精度2:4																																										
其他说明				标识样式>>>																																						
1. 机械1层(*.GM1)为外形铣边; 若存在工艺副边, 请在副边上增加分流点 2. 请用供应商UL认证号, 防火等级, CTI等级, 生产周期替换放置在板上的UR标识, 且保持其位置、方向一致; 禁止添加板内不存在的标识, 包括供应商LOGO、无铅等。但工艺副边不受限 3. 若焊盘开窗与丝印油冲突, 焊盘处需将丝印油掏开, 不允许上盘 4. 若存在V-CUT, 无特别说明时, 须为双面V-CUT, 角度30 (+-5°), 余量按以下表格执行 <table><tr><td>筋厚</td><td colspan="7">PCB厚度 (mm)</td></tr><tr><td>(余量)</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1</td><td>1.2</td><td>1.6</td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td></tr><tr><td>最小值</td><td>0.16</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>最大值</td><td>0.32</td><td>0.4</td><td>0.45</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.8</td></tr></table> 5. PCB做完后, 请高温烘烤进行应力释放, 再整平 (或重物压板烘烤), 防止翘曲 6. 我司生产使用无铅工艺制程 7. 未尽事项请参照我司《PCB质量补充协议》								筋厚	PCB厚度 (mm)							(余量)	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3	最小值	0.16	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	最大值	0.32	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8
筋厚	PCB厚度 (mm)																																									
(余量)	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3																																		
最小值	0.16	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5																																		
最大值	0.32	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8																																		



- 技术要求:
- 1、图纸比例为1:1;
 - 2、线路板厚度为1.6mm, 板上设置通孔1、通孔2;
 - 3、橙色线为盒盖内表面加强筋区域, 为避免装配干涉, ①~⑧区域为芯片及电子器件可布置区域, 电子器件焊接后距线路板背面高度控制在4mm以内;
 - 4、线路板正面需设置LED灯, 用于判断是否离手, LED位置如图所示。